

設備作業標準(SE-031 化學機械研磨系統)

一、目的：

定義 CMP 化學機械研磨系統操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用 CMP 化學機械研磨系統。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過 CMP 化學機械研磨系統考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

Model 372M MANUAL

六、標準作業程序：

1. 刷卡開機。
 2. 按 ENTER ACCESS CODE 鍵輸入機台密碼。
 3. 在 Manual Operations 選項上按 FLUSH FLUID LINES，沖洗待機狀態的機台管路。
 4. 到 Process Management 選項上 LOAD 一個新製程參數。
 5. 把漿料管路放入研磨漿中，然後到 Polish Control 選項上執行合適的 SLURRY TEST，直到漿料流注於研磨墊上。
 6. 在 Phase setup1 選項上設定研磨時間並確認製程參數。
 7. 到 Phase setup2 選項上確認製程參數，同時確定所使用的研磨漿。
 8. 當晶圓放入晶舟後，按 Load Service Switch 鈕使機台 IN-SERVICE。
 9. 按 SPINDLE ON 鈕，再按 START 鈕開始製程，下面的流程將自動執行:載入程序，研磨程序，清洗過程以及晶圓送出。
 10. 研磨結束，按 END 鈕。
 11. 按 Unload Service Switch 鈕將晶圓取出。
 12. 到 Polish Control 選項上按 SLURRY TEST，然後把漿料管路放入純淨的 DI 水中清洗，直至清水流注於研磨墊上。
-

設備作業標準(SE-031 化學機械研磨系統)

13. 在 Manual Operations 選項上按 FLUSH FLUID LINES 進行清洗。
 14. 按 SPINDLE ON 鈕，檢查 Carrier 是否在清洗槽，同時槽中注滿 DI 水。
 15. 檢查 Arm IO 選項上 PSI SELECT 是否燈亮；若否，則按鍵使它亮起。
 16. 檢查轉盤是否轉動並定時噴水濕潤研磨墊。
 17. 按 ENTER ACCESS CODE 鍵輸入任一數字鎖住機台。
 18. 刷卡關機。
-